

Предназначены для изготовления керамических конденсаторов 2 типа и других изделий электронной техники с использованием любого метода керамической технологии: прессования, экструзии, литья пленки и так далее.

Соответствуют требованиям ОСТ 11 0309-86 «Материалы керамические для изделий электронной техники» и МЭК.

Имеют широкий спектр диэлектрической проницаемости, могут быть изготовлены любой группы температурной стабильности.

Марка материала	Группа температурной стабильности (МЭК)	ϵ (20°C, 1 кГц)	$\text{tg}\delta$ (20°C, 1 кГц)	Удельное объемное сопротивление, ГОм·м	Электрическая прочность, кВ/мм	Интервал рабочих температур, °C	Температура спекания, °C
Материалы с низкой температурой спекания							
T2H-A	X7R (2R1)	2300 ...	0,008 ...	min 20	min 5	-60 ... +125	1100 ...
		2500	0,015				1140
TH-10000	Y5V (2F2)	10000 ...	0,008 ...	min 20	min 4	-60 ... +85	1100 ...
		11000	0,015				1140
Материалы для многослойных керамических конденсаторов с никелевыми электродами							
HB-2000	X7R (2X1)	2300 ...	0,008 ...	min 1,0	min 4	-60 ... +125	1320 ...
		2500	0,012				1360
HB-8000	X5V (2F2)	9000 ...	0,006 ...	min 1,0	min 3	-60 ... +85	1320 ...
		11000	0,008				1360
Материалы с высокой диэлектрической проницаемостью							
БЦН	Z4V	20000 ...	0,006 ...	min 10	min 4	+10 ... +65	1320 ...
		22000	0,008				1380

*T2H, TH-10000 – материалы позволяют использовать в качестве электрода многослойных конденсаторов сплав 70% Ag – 30% Pd

* HB-2000, HB-8000 – обжиг многослойных конденсаторов с Ni электродами должен проводиться в защитной газовой атмосфере CO/CO₂